



意法半導體建立中的義大利300mm類比和功率晶圓廠專案加入Tower半導體

合作雙方將加速ST Agrate R3 300mm晶圓廠產能提升，以達到大量量產規模

【台北訊，2021年6月25日】—服務橫跨多重電子應用領域的全球半導體領導者意法半導體（STMicroelectronics，簡稱ST；紐約證券交易所程式碼：STM）和世界領先的高價值類比半導體解決方案代工廠Tower半導體公司（NASDAQ：TSEM & TASE：TSEM）宣布一項合作協定，意法半導體將歡迎Tower加入其在義大利Agrate Brianza廠區建立中的Agrate R3 300mm晶圓廠專案。意法半導體和Tower將聯手加速晶圓廠達量產規模，因為量產時程加速是達到高產能利用率以提升晶圓成本競爭力的關鍵因素。ST和Tower將共享R3無塵室，總面積的三分之一將安裝Tower的自有設備。晶圓廠預計將於今年底準備安裝設備，2022年下半年開始生產。

意法半導體和Tower將共享無塵室和基礎設施，投資購買安裝各自的製程設備，共同努力加速完成晶圓廠的製程驗證和後續產能提升。工廠運營將繼續由意法半導體負責，Tower指派人員將借調至意法半導體擔任支援晶圓廠製程驗證和量產加速，以及其他工程和製程相關職位。R3工廠初期階段將先完成130nm、90nm和65nm智慧電源、類比混合訊號和射頻製程的驗證，採用這些技術的半導體產品主要應用於汽車、工業和個人電子。

意法半導體總裁暨執行長Jean-Marc Chery表示，「產能利用率是衡量一個晶圓廠的工業績效和經濟績效的關鍵參數。在類比、功率和混合訊號晶片量產過程中，在Tower優質合作夥伴的加入下，將讓Agrate R3 300mm晶圓廠製程驗證和量產時程大幅加速，幾乎從生產初期就可以達到優化的產能利用率。晶圓廠全面竣工後的產能甚至將高於2018年我們預估的產能。Agrate R3製造的產品將供應汽車、工業和個人電子市場，在中長期內緩解各種應用晶片的供貨壓力。」

Tower執行長Russell Ellwanger則表示，「我們很高興宣布與意法半導體的合作。ST的先進技術、高效生產運營和誠信經商聞名業界，我們期待雙方互利共贏。Agrate的合作案將會顯著增進Tower既有65奈米製程技術在300mm晶圓類比射頻、功率平台、顯示晶片等強力執行力，三倍於既有Tower的300mm晶圓代工產能將滿足客戶不斷成長的需求。」

為了執行該專案，Tower將成立一家全資義大利子公司。隨著專案的進展，Tower將揭露有關其重要之資本支出投資計畫和投資規模的詳細資訊。

關於意法半導體

意法半導體（STMicroelectronics; ST）擁有46,000名半導體技術、產品和方案的創新和創造者，掌握半導體供應鏈和最先進的製造設備。作為一家獨立的半導體設備製造商，意法半導體與逾十萬客戶、上千合作夥伴一起研發產品和解決方案，共同打造生態系統，一同攜手應對各種挑戰和機會，滿足世界對於永續發展之更高的需求。意法半導體的技術讓人們出行更智慧、電力和能源管理更高效、物聯網和5G技術應用更

廣泛。詳情請瀏覽意法半導體公司網站：<http://www.st.com>。

關於Tower半導體

Tower半導體 (NASDAQ : TSEM · TASE : TSEM) 是世界領先的類比半導體解決方案代工廠，為消費、工業、汽車、行動、基礎設施、醫療、航空航太和國防等成長型市場提供積體電路技術和製程平台。Tower半導體專注於透過長期合作策略和先進、創新的類比技術，在推動世界永續發展中發揮積極的影響。Tower的類比半導體技術包括各種客製化製程平台，例如，SiGe、BiCMOS、混合訊號/CMOS、RF CMOS、CMOS影像感測器、非影像感測器、整合電源管理 (BCD 和 700V) 和 MEMS。Tower半導體還提供世界一流的積體電路設計支援服務，加速晶片設計週期，提升設計準確率，以及向IDM和無晶圓廠公司提供製程研發、轉讓和優化等製程輸出服務。為了提供客戶多晶圓廠貨源和擴大產能，Tower半導體在以色列擁有兩個製造工廠 (150mm和 200mm)，在美國有兩個工廠 (200mm)，在日本TPSCo廠區設立三個工廠 (兩個200mm和一個300mm)。預知更多資訊，請造訪：www.towersemi.com。

本新聞稿，包括對該專案之前景、時程表和投資金額，以及我們各自的業務和活動所提供之任何預測，以及前瞻性陳述，這些陳述受風險和不確定性的影響。實際結果可能與此類前瞻性陳述所預測或暗示的結果有所不同，不應過分依賴此類前瞻性陳述。潛在風險和不確定性包括但不限於與晶圓廠建立、產品和技術認證時間表、投資金額和其他條款、合資企業和 / 或先進技術產能加強的資本租賃交易相關的風險和不確定性，所有這些都可能需要新的客戶參與、技術和製程認證，生產設施的提升，以及某些專案可能需要額外資金，如果有的話，無法以有利條件確保其可用性。

針對可能影響本新聞稿中包含的前瞻性陳述的準確性，或可能以其他方式影響各自業務的風險和不確定性的完整討論，包含在ST和Tower近期提出之Forms 20-F和Forms 6-K中的「風險因素」標題下，Forms 20-F和Forms 6-K已分別送交至證券交易委員會 (“SEC”)、荷蘭金融市場管理局和以色列證券管理局。未來的結果可能與之前報告的結果大不相同。ST和Tower不打算更新本新聞稿中包含的資訊，並且明確表示不承擔任何更新資訊的義務。